

ZTE中兴

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

董事會公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 中興通訊股份有限公司(以下簡稱「本公司」)與中國移動通信集團公司(以下簡稱「中國移動」)簽訂產品銷售合同

2007年6月7日，本公司及其控股子公司深圳市中興通訊技術服務有限責任公司(以下簡稱「中興技服公司」)與中國移動簽訂了 TD-SCDMA 規模網絡技術應用試驗網建設項目商務合同(以下簡稱「該等合同」)。根據該等合同約定，本公司及中興技服公司將向中國移動提供總金額約23.7億元人民幣的產品及工程服務(其中產品銷售合同金額約佔該等合同總金額的90%)。

該等合同已經本公司、中興技服公司與中國移動雙方簽署生效，並已開始執行。

二、 本公司與美國高通公司(QUALCOMM Incorporated)簽訂芯片採購框架協議

- 1、 本公司2006年4月曾與美國高通公司簽署了《2006年 - 2007年芯片採購框架協議》(以下簡稱「《芯片採購框架協議》」)，約定本公司有意於2006年 - 2007年期間向美國高通公司採購價值總計約3億美元的芯片。

本公司近期隨中國機電貿易投資合作促進團訪問美國，根據2006年的芯片採購情況，與美國高通公司修訂了《芯片採購框架協議》，本次修訂將《芯片採購框架協議》中的2006年 - 2007年期間向美國高通公司採購芯片價值提高至約5億美元。

2、 美國高通公司介紹

美國高通公司從2001年開始成為本公司的芯片供應商，本公司每年均會向美國高通公司採購芯片，其屬於本公司正常的原材料採購行為。

美國高通公司總部設於美國加利福尼亞州聖荷西市，是 CDMA(碼分多址)數字無線技術的先驅，也是推動3G無線產品和服務發展的領導廠商之一。美國高通公司在開發 CDMA2000® 1X、1xEV-DO 和 WCDMA (UMTS) 芯片組和解決方案方面走在世界前列，同時將其核心 CDMA 專利技術授權給全球多家通信設備廠商。

3、風險提示

- (1) 本公司與美國高通公司本次簽署的《芯片採購框架協議》是就協議雙方合作意圖所作的闡述，不對任何一方構成約束，也不會在協議雙方之間設定任何法律權利或義務。
- (2) 本公司與美國高通公司雙方之間任何確定的交易應以雙方簽訂的長期供貨合同和具體訂單為準，本公司將根據生產經營情況逐步進行採購，實際執行情況可能與該《芯片採購框架協議》存在偏差。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國
二零零七年六月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。